



5G対応法人向けスマートフォン「DIGNO® BX2」 ソフトバンクより登場

ビジネスシーンでも安心の大容量バッテリーと優れた耐久性

京セラ株式会社 2021年10月27日

京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫、以下京セラ）は、ソフトバンク株式会社（以下ソフトバンク）向けの新製品として、「DIGNO BX2」を製品化しましたので、お知らせします。本製品は2021年11月下旬以降にソフトバンクより法人向けでの販売を予定しています。



「DIGNO-BX2」

商品名	DIGNO-BX2
カラー	ブラック
価格	オープン価格
販売元	ソフトバンク株式会社

本製品は5G対応のため、テレワークやオンライン会議などに最適な端末です。防水※1・防塵※2・耐衝撃※3性能にも対応しており、また、4,500mAhの大容量バッテリーを搭載するなど、日々のビジネスシーンをサポートします。さらに、Google™ 社の法人利用に適した端末認定プログラム Android Enterprise Recommended に対応しているので、安心してお使いいただけます。
本製品は企画から開発、製造、アフターサービスまでを国内で一貫して行う安心のJAPAN MADE製品です。

■「DIGNO-BX2」の主な特長

1. ビジネスシーンをサポートする機能

(1) 5G対応
5G対応のため、高速、大容量通信などを可能にします。テレワークやオンライン会議などのシーンに最適です。

(2) すぐれた耐久性
・MIL規格20項目に準拠しており、万一ポケットやバッグから落としても壊れにくい耐衝撃※3や、外出時にも安心の防水※1・防塵※2設計となっています。
・2段強化ガラスを採用しているため、割れにくく、従来の強化ガラス採用時よりも1.2倍以上
の強度を実現します。

(3) 大容量バッテリー
4,500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。別途「USB Type-C™(C-C)ケーブル」を使用することで、「DIGNO☒BX2」から他の端末などに電池の供給が可能です。

(4)「グローブタッチ☒」/「ウェットタッチ☒」
グローブを着けたままでも使える「グローブタッチ☒」と画面や手が濡れた状態でも使える「ウェットタッチ☒」に対応しています。

2. 使いやすいデザイン
端末のディスプレイには約6.1インチの大型ディスプレイを採用しながら、端末サイズは横幅約72㎜と、しっかりと手に収まるサイズで持ちやすいスリムなデザインです。さらに、端末のボディには傷や摩耗跡が目立ちにくいシボ加工を施しました。



3. 便利な通話機能
通話終了後に直前の通話内容を音声データとして保存し、あとから聞き直すことができる「通話後録音」機能を搭載しています。

4. 安心のセキュリティ機能とJAPAN MADE
(1) 顔認証機能
フロント（イン）カメラでのAIによる顔認証機能に対応しているため、安心してお使いいただけます。

(2) Android Enterprise Recommended **対応**
Google 社の法人利用に適した端末認定プログラム Android Enterprise Recommended に対応しています。最新OSへのアップデートや、定期的なセキュリティパッチが適用されるので、情報漏洩や不正使用を防ぐことができます。

(3) JAPAN MADE
企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまでを一貫して国内で実施しています。迅速、かつ確実なサポート体制を有するので安心してお使いいただけます。

■「DIGNO－BX2」の製品情報とお問い合わせについては、下記サイトをご覧ください。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/digno-bx2/index.html?kcnews

■「JAPAN MADE」についての詳細は下記サイトをご覧ください。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/jm/?kcnews

■「DIGNO－BX2」の主な仕様

ディスプレイ	約6.1インチ/FHD+
サイズ（高さ×幅×厚さ）	約156×72×8.9㎜（突起部を除く）
重量	約168g
連続通話時間※4	4G LTE™：約2,470分/3G：約1,970分/GSM：約990分
連続待受時間※5	4G LTE™：約680時間/4G：約680時間/3G：約710時間/GSM：約700時間
バッテリー容量	4,500mAh
OS	Android™ 11
CPU	Qualcomm Snapdragon™ 480
内蔵メモリ（ROM/RAM）	ROM:64GB/RAM:4GB
外部メモリ	microSDXC™（最大1TB）
カメラ	アウト:約800万画素 イン　:約800万画素

Wi-Fi	IFFF802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）
Bluetooth	Ver.5.1
生体認証	顔認証
防水※1/防塵※2/耐衝撃※3	防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP6X）/耐衝撃（MIL規格準拠）

※1【防水について】IPX5：内径6.3mm のノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8：常温で水道水、かつ静水の水深約1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを浸けたり、かけたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。
※2【防塵について】IP6X：防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が内部に入らないように保護されていることを意味します。
※3【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ約1.22m から鋼板に製品を26 方向で落下させる試験、および以下の京セラ独自試験（高さ約1.5m から鋼板に製品を26 方向で落下させる試験）を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではございません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

＜MIL-STD-810H について＞
米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の20項目に準拠した試験（Blowing Rain（風雨）降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s 環境下で30分間の降雨試験、Immersion（浸漬）約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、Rain Drip（雨滴）高さ1m 雨滴（15分）の防水試験、Sand and Dust（粉塵）連続6時間（風速8.9m/s、濃度10.6ｇ/ ）の粉塵試験、Shock（落下）高さ約1.22mから26方向で鋼板に落下させる試験、Shock（衝撃）衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験、Vibration（振動）3時間（3方向各1時間/20~2,000Hz）の振動試験、Solar Radiation（太陽光照射）連続20 時間1,120W/ ㎡の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験、Humidity（湿度）連続10日間（湿度95%RH）の高湿度試験、High Temperature（高温動作）動作環境：50℃で連続3 時間の動作試験、High Temperature（高温動作）動作環境：32～49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験、High Temperature（高温保管）保管環境：60℃で連続4 時間の高温耐久試験、High Temperature（高温保管）保管環境：30～60℃まで変化させる高温耐久試験、Low Temperature（低温動作）動作環境：-21℃で連続3時間、Low Temperature（低温保管）保管環境：-30℃で連続4時間の低温耐久試験、Temperature Shock（温度衝撃）-21～50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、Low Pressure（低圧動作）連続2時間（57.2kPa/ 高度約4,572m相当）の低圧動作試験、Low Pressure（低圧保管）連続2時間（57.2kPa/高度約4,572m相当）の低圧保管試験、Freeze-Thaw（凍結- 融解）-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験、Icing/Freezing Rain（氷・低温雨）-10℃の冷却水で6mm 厚の氷が張るまで氷結させる試験）を実施。
※4 連続通話時間とは、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
※5 連続待受時間とは、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

※「DIGNO」、「グローブタッチ」、「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。
※高速大容量5G（新周波数）は、限定されたエリアで提供しています。詳しくはソフトバンクのホームページをご覧ください。
※「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。
※LTE はETSI の商標です。
※SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
※Google、Android、Google Play、Gmail、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
※Qualcomm及びSnapdragonはQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製品です。
※microSDXC™はSD-3C,LLC の商標です。
※Wi-Fi® はWi-Fi Alliance の登録商標です。
※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
※USB Type-C™はUSB Implementers Forum の商標です。
※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
※製品仕様は、本リリース作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。
※画面・画像は全てイメージです。

記載されている内容は、発表日現在のものです。ご覧になった時点ではその内容が異なっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。